

## 杭州晶华微电子股份有限公司

## 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的资产减值损失 676.93 万元，具体情况如下表：

序号	项目	2023 年半年度计提金额（万元）	备注
1	信用减值损失	13.34	坏账损失
2	资产减值损失	663.59	存货跌价损失
	合计	676.93	

### 二、计提资产减值准备事项的具体说明

#### 1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。本次需计提信用减值损失金额共计 13.34 万元。

#### 2、资产减值损失

在资产负债表日，公司按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合产品预计售价、存货的库龄、通用性及周转情况对存货进行减值测试。由于 2021 年芯片供应短缺，产业供应链中下游厂商均备货较多，叠加 2022 年下半年以来宏观经济和半导体下行周期因素影响，导致去库存周期拉长，存货跌价准备计提增加，2023 年半年度计提存货跌价损失金额共计 663.59 万元。

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司 2023 年半年度合并利润总额影响 676.93 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

### 四、其他说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日